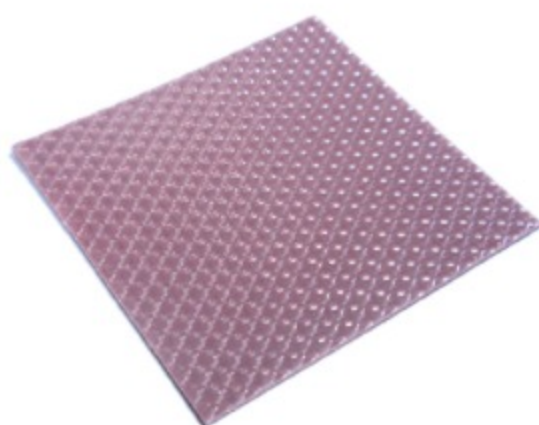


α-オレフィン系材料を使用しており、従来のシリコン系材料で懸念されていた低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害を引き起こしません。



製品カタログはこちら

型番	WW-SF-S05
熱伝導率	2.0W/m・K
使用温度範囲	-40℃～110℃
JANコード	4524945012011
寸法	50mm×50mm×厚さ0.5mm

仕様	<p>ベースポリマー α-オレフィン 硬さ 35 (JIS Type E) 比重 1.8 体積抵抗値 $\geq 1 \times 10^{10}$ の10乗 ($\Omega \cdot \text{cm}$) 絶縁破壊電圧 ≥ 10 (AC kV/mm) 耐電圧 ≥ 10 (AC kV/mm) 難燃性 V-0 (UL94) 片面粘着、シリコンフリー RoHS 2.0適合 絶縁性 本製品はCEマークは取得されておりません。</p>
----	--

製品PR	<ul style="list-style-type: none"> 発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。(熱源と放熱体の間に挟んで使用します。) 発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)とのすきま(ギャップ)や凹凸を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。 熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。また、難燃性を有し、作業性・加工性に優れた放熱シートです。 柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。 復帰性が良好でリワーク性に優れます。
------	--

備考	<p><u>低分子シロキサン電気接点障害とは</u> 従来のシリコン系材料では、発熱体の動作熱により低分子シロキサンが発生し、電気接点障害を誘発することがあります。 誘発する例としましては、リレーの接点不良が多く、密閉された環境下でシリコンを使用していると、シロキサンが発生し、リレー接点上に付着します。特にON/OFF回数の多いリレーは接点のON/OFFを繰り返すことにより、接点上に付着したシロキサンを酸化分解させ、二酸化ケイ素(SiO₂)となり、電気絶縁物として接点障害を引き起こします。</p>
----	--